

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

## 灿芯半导体（上海）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国泰基金、华商基金、华泰证券、天风证券
时间	2026年6月24日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书沈文萍女士 证券事务代表石啸天、梁砚卿
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>公司情况简要介绍：</p> <p>灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。</p> <p>依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市等行业。</p> <p>投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>1、公司 2025 年度和 2026 年第一季度经营情况？</p> <p>答：2025 年，公司实现营业收入 72,444.62 万元，其中公司芯片设计业务实现收入 36,732.54 万元，较去年同期上升 30.69%，公司芯片设计业务报告期内发展情况良好。公司 2025 年度完成流片验证的项目数量为 275</p>

个，较 2024 年增长 44.74%。芯片量产业务实现收入 35,712.08 万元，较去年同期下降 55.83%，主要系本报告期部分客户因其需求变化对公司采购下降所致。报告期内，随着客户需求逐渐恢复及部分项目逐步导入量产阶段，公司芯片量产业务环比呈现改善态势，公司 2025 年下半年芯片量产业务收入较 2025 年上半年增长 54.82%。

2026 年第一季度，公司实现营业收入 1.71 亿元，同比增长 23.39%，其中，芯片设计业务实现营业收入 0.58 亿元，同比下降 24.63%，芯片量产业务实现营业收入 1.14 亿元，同比增长 82.29%。

## 2、芯片设计服务市场的进入难度如何？

答：由于芯片设计服务企业需要面向不同领域进行设计，而不同领域芯片在技术特点与设计难度各不相同，需要设计服务企业针对不同领域进行长期设计积累。同时，芯片设计服务企业往往需要具备全方位的芯片设计能力才能够满足客户的一站式定制需求，而在多工艺节点上形成全方位设计能力并积累工艺诀窍需要长时间的技术积淀，进入难度较大。此外，芯片设计服务行业属于技术密集型行业，技术难度较高，且客户出于设计成本、设计风险、产品验证时间等方面的综合考虑，其针对芯片定制产品一旦选定供应商则不轻易更换，准入门槛较高。

## 3、公司目前的在手订单情况？

答：截至 2026 年 3 月 31 日，公司在手订单金额为 9.22 亿元（含税，下同），其中芯片设计业务在手订单 4.08 亿元，芯片量产业务在手订单 5.14 亿元。

## 4、公司目前在 IP 研发方面主要围绕哪些领域展开？

答：公司目前主要围绕高速接口 IP 和高性能模拟 IP 开展研发。在高速接口 IP 领域，公司目前开展研发的 IP 主要包括 DDR、SerDes、PCIe、MIPI、PSRAM、TCAM 等；在高性能模拟 IP 领域，公司目前开展研发的 IP 主要包括 ADC、PLL、PMU 等。

## 5、公司芯片设计业务与量产业务之间的关系？

答：公司的主要经营成果来源于一站式芯片定制业务，包括芯片设计业务收入及由芯片设计业务转化形成的芯片量产业务收入，其中公司芯片量产业务是芯片设计业务的延伸。在芯片设计阶段，公司依托自身多工艺

平台、多工艺节点的完整芯片设计能力，能够从芯片设计环节的任一节点介入并完成余下的全部设计工作，最终高效、低风险地完成芯片设计。在量产阶段，由于不同项目所用制造工艺节点、工艺特点各有所不同，公司依托自身量产管理能力对量产良率、周期进行动态检测及改进，满足客户产品需求。基于完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。

#### 6、公司对未来发展的展望？

答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。公司后续主要经营计划包括：

(1) 技术研发创新：公司将进一步加大研发投入，提升自主创新能力、完善研发体系与质量管理体系，对现有的以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系进行持续研发，不断为客户提供高质量、高效率、低成本、低风险的一站式芯片定制服务。

(2) 市场拓展：一方面，公司将加强市场开拓力度，重点布局汽车电子、端侧 AI、AI+IoT 等高潜力领域，加速技术研发成果的市场化应用，增强公司核心竞争力；另一方面，公司将拓展销售与服务网络的覆盖度，提升销售团队整体专业素质，优化公司营销模式。

(3) 研发团队建设与管理效能提升：公司重视人才引进，立足公司实际情况，积极同国内外科研院所、高校和企业进行交流，注重国内外高端专业技术人才的引进。与此同时，公司实施人才培养计划，健全公司内部培训、人员考核评价、晋升及优化机制，加强公司在创新文化、员工职业生涯规划、内部知识共享、员工领导能力建设方面的投入，持续提升员工队伍素质。此外，公司还将优化管理流程，提升流程效率，优化整体管理效能，降低公司运营成本。

(4) 并购重组与资源整合：在高度竞争的产业形势下，公司将在自身成长的同时，积极寻求并购机会，从而使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与公司的兼容性，保障公司核心竞争力的加强和进一步发展。

附件清单

无

日期

2026 年 6 月 24 日

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
-----------------------	---